

関係各位

一般社団法人 電子情報技術産業協会  
半導体パッケージ技術小委員会  
主 査 吉田 浩芳

### 2015 年度 パッケージング技術セミナー開催のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、半導体パッケージ技術小委員会諸活動に対しまして、格別なるご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、当該小委員会では、2016 年度の半導体設計技術小委員会の発足を機に、高まっている半導体設計技術について、半導体・パッケージ・実装ボードなどにおける協調設計、熱設計技術、実装分野における 3 次元フォーマットの標準化動向など、あらゆる観点から考えてみる機会を作りたいと考え、以下のセミナーを企画致しました。

なお、2016 年度から有料化することも考えており、無料で参加できるのは今回限りとなる予定ですので、大変ご多忙中とは存じますが、広くご周知頂き、多くの皆様の参加をお待ちしております。

また、セミナー終了後に当協会内で懇親会(立食形式)を開催致します。お時間の許す限り皆様でご歓談ください。

敬具

#### 記

名 称： 「2015 年度 パッケージング設計技術セミナー ～重要性を増すパッケージ設計技術～」

日 時： 2016 年 2 月 18 日 (木) 13:00 ～ 17:00 ( 受付開始 12:45 ～ )

場 所： 一般社団法人 電子情報技術産業協会 413 会議室  
(東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル 4 階)  
地図：<http://www.jeita.or.jp/japanese/about/location>

定 員： 40 名 (定員に達し次第、締切)

参加申込： 別紙申込書に必要事項ご記入の上、事務局宛お申込み下さい。(参加費無料)

申込期限： 2016 年 2 月 16 日(火)までにお申込み下さい。

#### プログラム

13:00-13:05	開催挨拶 半導体パッケージ技術小委員会 主査 吉田 浩芳 (パナソニック株)
13:05-13:45	最近の熱設計動向と取り組むべき課題 株式会社サーマルデザインラボ 代表取締役 国峯 尚樹 様
13:45-14:25	ジャンクション温度がわかる、簡易&詳細の過渡熱モデルとその秘訣 株式会社デンソー 篠田 卓也 様
14:25-14:45	(休憩)
14:45-15:25	LPB 協調設計技術 半導体設計技術小委員会(2016 年度発足) LPB-WG 古賀 一成 (株図研) 様
15:25-16:15	SiC パワーデバイスとその応用の最新動向 株式会社東芝 四戸 孝 様
16:15-16:55	部品内蔵基板設計データフォーマットの有効性と国際標準化 TC91/WG6 エキスパート 松澤 浩彦 (株図研) 様
16:55-17:00	閉会挨拶 (調整中)

※プログラムの内容につきましては、変更となる場合もございますので予めご承知おきください。

<提出先> [device3@jeita.or.jp](mailto:device3@jeita.or.jp)

会社名: \_\_\_\_\_

氏 名	所 属 ・ 役 職 名	E-mail	参加回答 (必要な記載だけ残す)
			セミナー・懇親会
			セミナー・懇親会
			セミナー・懇親会

※「参加回答」部分は、必要な記載だけを残して提出願います。

※申し込み時に入力いただきました個人情報は本セミナーの受付、次回ご案内の為に使用いたします。  
他の目的で使用することはありません。

※JEITA の個人情報保護方針につきましては下記をご参照ください。

<http://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>

■お問合せ先

半導体パッケージ技術小委員会 担当事務局

一般社団法人電子情報技術産業協会 電子デバイス部 (木暮・吉井)

TEL 03-5218-1061 FAX 03-5218-1080 E-Mail [device3@jeita.or.jp](mailto:device3@jeita.or.jp)